

证券代码：688691

证券简称：灿芯股份

公告编号：2025-020

灿芯半导体（上海）股份有限公司 关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，将灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2025 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会于 2024 年 1 月 17 日出具的《关于同意灿芯半导体（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]106 号）批准同意，公司首次公开发行人民币普通股 3,000.00 万股，本次发行募集资金总额 59,580.00 万元；扣除发行费用后，募集资金净额为 52,129.49 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2024 年 4 月 8 日出具了《验资报告》（容诚验字[2024]200Z0016 号），验证募集资金已全部到位。上述募集资金已经全部存放于经董事会批准的募集资金专户管理，公司及公司子公司灿芯半导体（苏州）有限公司（以下简称“灿芯苏州”）已与保荐人国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。

（二）2025 年半年度募集资金使用情况及结余情况

2025 年 1-6 月，本公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金总额	59,580.00
减：发行费用合计	7,450.51
募集资金净额	52,129.49
减：累计至 2025 年 6 月 30 日募投项目实际支出金额	12,434.96
减：截至 2025 年 6 月 30 日用于现金管理金额	9,500.00
加：累计至 2025 年 6 月 30 日募集资金利息收入（扣除手续费净额）和投资收益金额	695.60
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金账户余额	30,890.12

注：本报告个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，均系数据计算时四舍五入造成，下同

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护中小投资者利益，本公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《灿芯半导体（上海）股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、管理以及监督等作出了具体明确的规定。

本公司及灿芯苏州已与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，截至 2025 年 6 月 30 日，监管协议履行正常。本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行上述协议，保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

公司	开户银行名称	银行账号	金额
灿芯半导体（上海）股份有限公司	招商银行股份有限公司上海分行营业部	121907617210001	6,202.51
灿芯半导体（上海）股份有限公司	浙商银行股份有限公司上海陆家嘴支行	2900000210120100179928	18,453.89
灿芯半导体（上海）股份有限公司	南京银行股份有限公司上海分行	03012300000009378	6,209.39
灿芯半导体（苏州）有限公司	中国建设银行股份有限公司苏州湖东新街口支行	32250198814609888888	24.33
合计			30,890.12

三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 12,434.96 万元（其中本报告期内投入 5,119.73 万元），具体情况详见“附表 1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2024 年 8 月 28 日，公司召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用募集资金人民币 3,172.42 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，使用募集资金人民币 448.85 万元置换已支付发行费用。保荐人出具了《海通证券股份有限公司关于灿芯半导体（上海）股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚专字[2024]200Z0340 号《关于灿芯半导体（上海）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。上述置换事项已于 2024 年 9 月实施完毕。

本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对暂时闲置募集资金进行现金管理情况

2024年8月28日，公司召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用不超过人民币20,000.00万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款等理财产品。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度范围内，资金可以循环滚动使用。保荐人出具了《海通证券股份有限公司关于灿芯半导体（上海）股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

单位：人民币万元

银行名称	产品类别	金额	起息日	到期日	年化收益率	截至报告期末是否完成赎回	期限（天）	收益
浙商银行	大额存单	10,000.00	2024/09/24	2025/03/24	1.80%	是	181	90.00
招商银行	定期存款	6,000.00	2024/09/06	2025/03/06	1.75%	是	181	52.50
招商银行	结构性存款	3,000.00	2025/01/10	2025/04/10	1.75%或2.00%	是	90	14.79
招商银行	结构性存款	6,000.00	2025/03/19	2025/06/19	1.75%或2.00%	是	92	30.25
浙商银行	大额存单	10,000.00	2025/03/25	2025/06/25	1.35%	是	92	33.75
招商银行	结构性存款	3,500.00	2025/04/16	2025/07/16	1.75%或2.00%	否	91	-
招商银行	结构性存款	6,000.00	2025/06/23	2025/07/24	1.00%或1.85%	否	31	-

截至2025年6月30日，公司闲置募集资金进行现金管理余额为9,500.00万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2025年6月30日，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司募集资金尚在投入过程中，不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目

2024 年 5 月 15 日，公司召开第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金向募集资金投资项目“工业互联网与智慧城市的定制化芯片平台”的实施主体灿芯苏州提供借款以实施募投项目。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐人对上述事项出具了明确同意的核查意见。

2、调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额

2024 年 5 月 31 日，公司召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额结合实际情况调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐人对上述事项出具了明确同意的核查意见。本次调整后，公司募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	总投资额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	网络通信与计算芯片定制化解决方案平台	29,929.32	29,929.32	26,002.19
2	工业互联网与智慧城市的定制化芯片平台	20,540.57	20,540.57	17,843.92
3	高性能模拟 IP 建设平台	9,534.86	9,534.86	8,283.38
合计		60,004.75	60,004.75	52,129.49

3、使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换

2024年8月28日，公司召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的议案》。同意公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用计划以及确保公司正常运营的前提下，使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐人对上述事项出具了明确同意的核查意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2025年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司已严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

灿芯半导体（上海）股份有限公司

董事会

2025年8月28日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额（注 1）				52,129.49		本年度投入募集资金总额（注 2）				5,119.73		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				12,434.96		
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（注 3）	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
网络通信与计算芯片定制化解决方案平台	否	29,929.32	26,002.19	26,002.19	2,863.11	7,870.64	-18,131.55	30.27	2027 年 4 月	不适用	不适用	否
工业互联网与智慧城市的定制化芯片平台	否	20,540.57	17,843.92	17,843.92	1,068.05	2,377.07	-15,466.85	13.32	2027 年 4 月	不适用	不适用	否
高性能模拟 IP 建设平台	否	9,534.86	8,283.38	8,283.38	1,188.57	2,187.25	-6,096.13	26.41	2027 年 4 月	不适用	不适用	否
合计	-	60,004.75	52,129.49	52,129.49	5,119.73	12,434.96	-39,694.53	23.85	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见“三、（四）对暂时闲置募集资金进行现金管理情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	详见“三、（八）募集资金使用的其他情况”相关内容

注 1：“募集资金总额”已扣除相关的发行费用。

注 2：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 3：公司于 2024 年 5 月 31 日召开公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额结合实际情况调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐人对上述事项出具了明确同意的核查意见。